绝缘性好稳定性高的陶瓷金属化电路板

产品名称	绝缘性好稳定性高的陶瓷金属化电路板
公司名称	富力天晟科技（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷创业街10栋1单元1层01室383号
联系电话	027-88111056 15527846441

产品详情

近几年，金属化陶瓷电路(基)板之应用领域越趋广泛，包含LED 封装基板、LED COB电路板、IGBT功率模组基板、车用电子电路载板、制冷晶片载板、HCPV电路板、医疗电子产品电路板等，这一切皆归因于陶瓷材料其优异的绝缘耐电压物理特性、化学稳定性、及其高性价比的导热系数特性(氧化铝导热系数约20～27W/m · K、氮化铝导热系数约170～190/m · K)等优势。

陶瓷基板因相关应用的需求，大多需要在基板的两个表面皆制作线路，并且大多需要透过导通孔填充导电物质(Through Hole Via Filling)的结构来连接双面线路，而且有些需要过大电流需要封孔，以电镀铜来填充导通孔是目前广泛使用于填充导通孔的工艺之一。影响其电镀填孔优劣的因素很多，与机器设备、物料状况、电镀手法、电镀药水等因素皆有关联。为解决直流电镀应用于填孔工艺面临之问题，我司采用脉冲电镀技术。脉冲电镀其实是一种通断的直流电镀，正负脉冲即是正脉冲后紧接着反向脉冲，按设置好的周期交替输出。脉冲电镀技术可改善镀层品质，相较于直流电源形成电镀镀层，脉冲电镀的镀层具有更优异的深镀能力、耐蚀、耐磨、纯度、导电、焊接及抗变色性能，且可大幅缩短电镀时间、降低成本；

斯利通主营氧化铝陶瓷电路板、氮化铝陶瓷电路板、氧化锆陶瓷电路板等，采用自主研发的激光快速活化金属化技术（Laser Activation Metallization, 简称LAM技术）技术制作而成。

陶瓷电路板技术参数：

可焊性：可在260°C多次焊接，并可在－20～80°C内长期使用

高频损耗：小，可进行高频电路的设计和组装

线/间距（L/S）分辨率：可达20μm

有机成分：不含有机成分，耐宇宙射线

氧化层：不含氧化层，可以在还原性气氛中长期使用

陶瓷电路板售后服务：

感谢您选购富力天晟科技有限公司陶瓷电路板，本产品严格按照国家质量体系标准进行质量控制。